



Investor Relations 2025

A Promising Journey to Silicon Success

ASICLAND

Disclaimer

본 자료는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 에이직랜드 이하 “회사”에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로, 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. 본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고(단, 출처표시 필수), 회사의 사전 승인 없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념해 주시기 바랍니다.

01

Company Overview

- 01. Corporate Identity
- 02. 회사개요
- 03. 핵심 경쟁력 – Top Level R&D
- 04. 핵심 경쟁력 – 독자적인 ASIC 설계 자동화 솔루션
- 05. 핵심 경쟁력 – 독보적인 레퍼런스



01. Corporate Identity



01. 국내 유일 TSMC VCA

- 글로벌 파운드리 No.1 TSMC의 생태계 핵심인 VCA로서 디자인 솔루션 내 독보적 위치
- TSMC의 VCA로서 높은 공정 이해도 기반 Spec-In부터 턴키 솔루션 제공



02. Arm의 ADP 공식 파트너

- 글로벌 최대 IP 기업 Arm의 지정 공식 파트너로서 글로벌 메이저 파트너들과 동반 성장
- 'Arm Total Design' 프로그램 파트너로 선정



03. ASIC 설계 자동화 플랫폼 보유

- 독보적인 SoC 설계 자동화 플랫폼 보유 (AWorld Magic™)
- 백엔드 설계 자동화 플랫폼 보유 (ALPS™)
- 온디바이스 AI 반도체 솔루션 보유 (TOAST™)



04. 독보적인 ASIC 설계 레퍼런스

- TSMC 공정 (1,000nm~3nm) 다양한 레퍼런스 보유
- 국내 최초 고대역대 기지국용 5G RF칩 개발 및 양산
- 국내 최초 서버용, 엣지용 AI 반도체 개발



글로벌 ASIC 디자인 솔루션 대표기업



05. 스케일업 선순환 수익 모델 구축

- 개발 후 양산으로 이어지는 스케일업 선순환 고리 장착
- 우량한 양산 파이프라인 보유 (2024.12월 말 기준)
 - 개발 중인 프로젝트 68건
 - 개발 수주 잔고 1,417억 원



06. Top-Level 설계 및 개발 역량

- 10년 이상 된 설계 베테랑 엔지니어의 높은 비중
- 스타트업부터 대기업까지 다양한 고객사 확보 (약 70社)
- 4차산업 가속화에 따른 애플리케이션 전방위 확대
- 대만 현지 '디자인 R&D 센터' 설립 완료
- 5nm 이하 선단 공정 내재화



07. 수익성 중심의 양산 비즈니스 확대

- SK 하이닉스와 5nm CXL 개발 후 양산
- 파두(FADU)와 차세대 eSSD 컨트롤러 개발 후 양산
- Edge AI 항 신규 개발 후 양산 프로젝트 확대 수주



08. 글로벌 시장 진출 가속화

- 대만 '디자인 R&D 센터' 설립을 통한 선단 공정 기술력 확보
- 미국 시장 진출을 통한 신규 고객사 확보
- 글로벌 IP사와의 MOU 체결을 통한 IP 비즈니스 확대



02. 회사개요



글로벌 ASIC 디자인솔루션 대표기업, 에이직랜드

일반 현황

이종민

대표이사

“글로벌 No.1 디자인 솔루션 기업으로”

- 2003 SK하이닉스 반도체 연구원
- 2005 (주)버추얼다임 책임연구원 : SoC개발팀
- 2009 (주)휴먼칩스 수석연구원 : ASIC개발팀
- 2012 (주)다윈텍 수석연구원 : ASIC개발팀
- 2016 (주)에이직랜드 대표이사



회사명	(주)에이직랜드
대표이사	이종민
설립일	2016년 4월 5일
자본금	54.35억 원
임직원수	242명 (25년 02월 현재 기준)
주요사업	주문형 반도체 디자인 서비스, 시스템 온 칩 제품 개발
주소	경기도 수원시 영통구 대학4로 25 에이직랜드빌딩
홈페이지	https://www.asicland.com

자료: 당사 내부자료

회사조직 구성



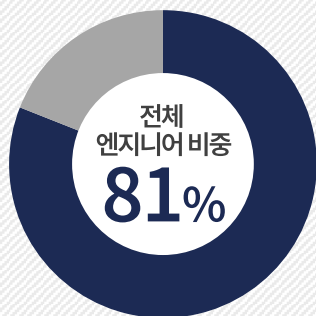
03. 핵심 경쟁력 – Top Level R&D



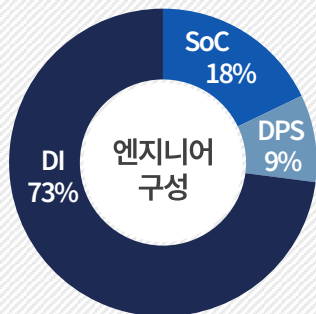
베테랑 설계 엔지니어들의 축적된 노하우와 경험 기반 다양한 고객사 니즈를 충족

엔지니어 현황

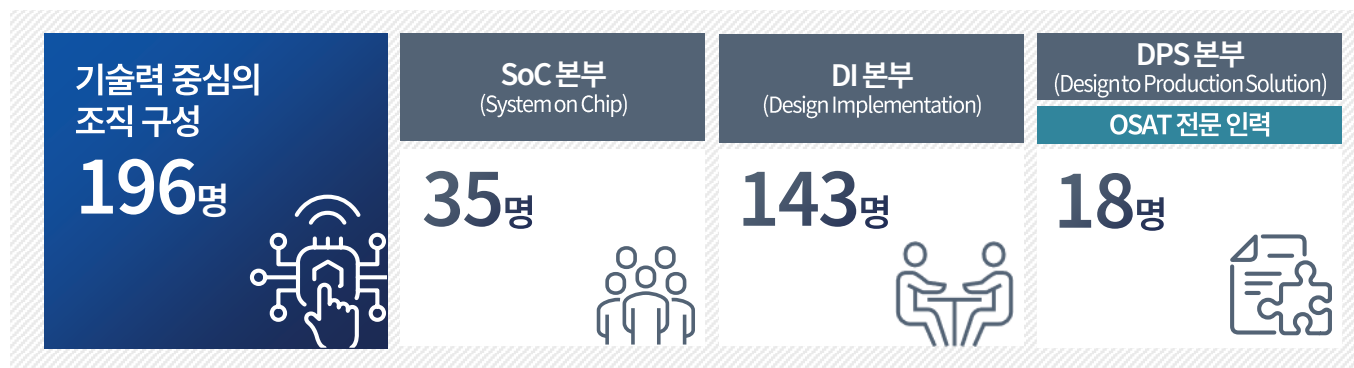
설계 베테랑 엔지니어의 높은 비중



엔지니어 인력 구성



엔지니어 구성



체계적인 양산 시스템 운영



자료: 당사 내부자료 (25년 02월 현재)

04. 핵심 경쟁력 – 독자적인 ASIC 설계 자동화 솔루션



반도체 설계 아키텍처, 검증된 개발 환경, 노하우를 자동화 플랫폼으로 담아내어 효율성 강화 및 높은 수익성 확보

Front-end 설계 자동화 플랫폼

에이직랜드만의 Spec-In 및
턴키 솔루션 노하우를 반영한 플랫폼

AWorld Magic™

자주 사용되는 IP DB 구축

GUI 기반 작업 편의성 증대

자동화 스크립트 제공으로 단순 작업 최소화

Back-end 설계 자동화 플랫폼

작업 순서 및 현황 제공을 통한
혁신적인 Back-end 설계 자동화 프로그램

ALPS™

작업 순서에 대한 개요 제공으로 작업 시간 단축

간단 명령으로 자동 생성 리포트 제공

최종 제품 경쟁력 제고

온디바이스 AI 반도체 솔루션

영상처리 장치를 기반으로 한
온디바이스 AI 반도체 설계 One-Stop 솔루션

TOAST™

AI 반도체 설계 아키텍처 템플릿 제공

검증된 One-Stop 개발 환경으로 효율적인 설계

세팅 된 환경을 활용하여 개발시간, 비용 절감

기대 효과

핵심 개발 프로젝트에 인력과 역량의 선택 집중 가능

안정성

엔지니어가 변경되어도
동일한 품질 산출

효율성

기존 대비 최대 **20%** 비용 절감

신속성

전체 개발 기간 **30%** 이상 단축

정확성

자동화를 통한 휴먼 에러 최소화

05. 핵심 경쟁력 – 독보적인 레퍼런스



에이직랜드는 AI, MEMORY 등 4차 산업 주요 고객에게 최적의 디자인 솔루션 제공
대기업과 중소기업, 스타트업 등 70여개의 다양한 고객사 확보 / 양산 가능성이 높은 어플리케이션 분야 집중



DISPLAY

- T-Con(Timing Controller) 제품화설계및 생산 지원
- 스마트글라스 컨트롤러



MEMORY

- 5nm CXL 개발 계약
- 차세대 eSSD 컨트롤러 개발 계약
- eMMC 컨트롤러 개발 계약



AI

- 국내 최초 AI 반도체 개발
- 엣지향 AI 반도체 신규 개발 계약
- HPC (고성능 컴퓨팅) CPU 개발



5G & IoT

- 세계 최초 고대역대 5G RF칩 양산
- 미국 기업 RF칩 신규 개발



AUTOMOTIVE

- 차량용 고속인터페이스 칩
- 자율주행 SoC 칩 개발



02

Business Performance

- 01. 2024년 주요 성과
- 02. 사업부별 매출 추이
- 03. 서비스별 매출 비중

A large, dark blue triangular graphic on the right side of the slide. It features a glowing blue circuitry pattern. In the center of the triangle, the letters 'AI' are prominently displayed in a bright, glowing white font, surrounded by a blue rectangular border that also glows.

AI

01. 2024년 주요 성과



4차 산업 핵심 반도체 신규 계약 체결 가속화

국내 주요기업 양산 사업 확대 • 대만 법인 설립 • 미국 시장 진출 가시화

Global



03.07.
Arm과 네오버스 CSS IP
라이선스 계약 체결

미국 팹리스와 첫 계약



06.21.
미국 PHY툰즈와 RF칩
신규 계약

해외 법인 설립



08.30.
대만 법인 설립
(R&D센터)



11.06.
대만 이지스테크놀로지와
글로벌 AI 서버 칩 공동 개발 협력

24.03

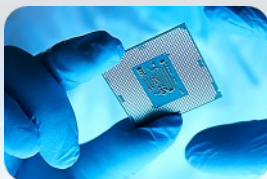
Local

05.13.
엠펙스 AI반도체 신규
계약 체결



24.06

07.31.
파두와 eSSD 컨트롤러
개발 계약 체결



24.08

08.16.
Arm '디자인 파트너
2023' 수상



24.11

11.04.
SK하이닉스와 5nm CXL
개발 계약 체결



5nm 턴키 과제 수주

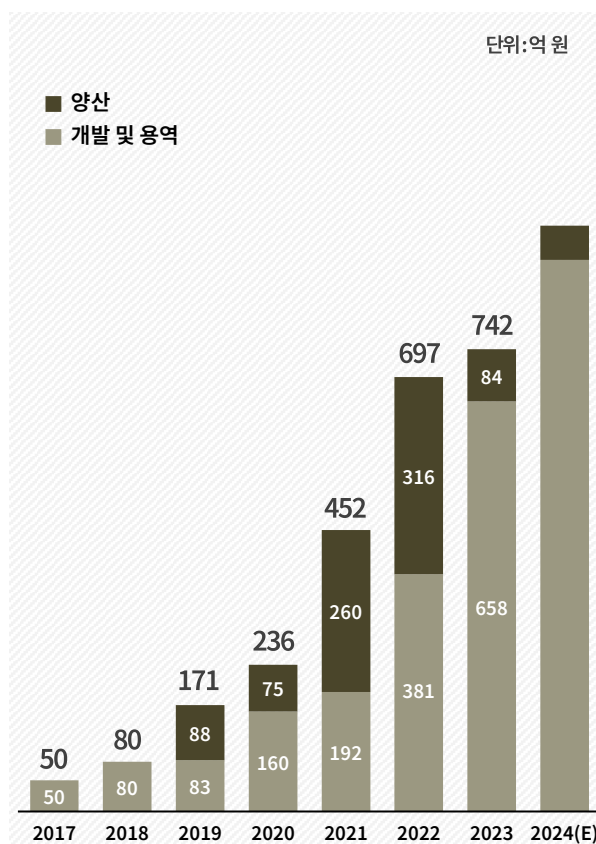
11.15.
딥엑스와 고성능 AI 반도체 칩
개발 계약 체결



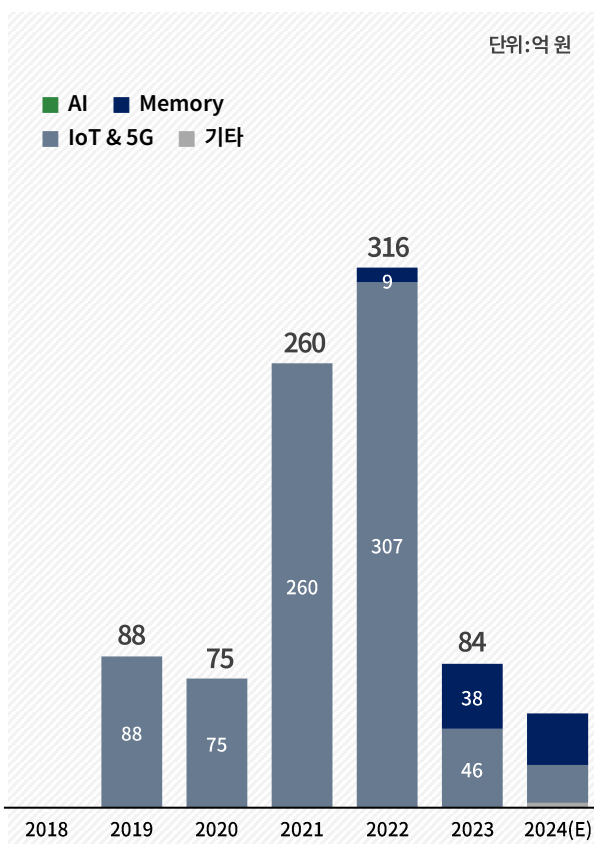
02. 사업부별 매출 추이

AI 반도체 부문이 빠르게 성장하고 있으며 양산 매출이 증가하는 급속 성장 구간 진입

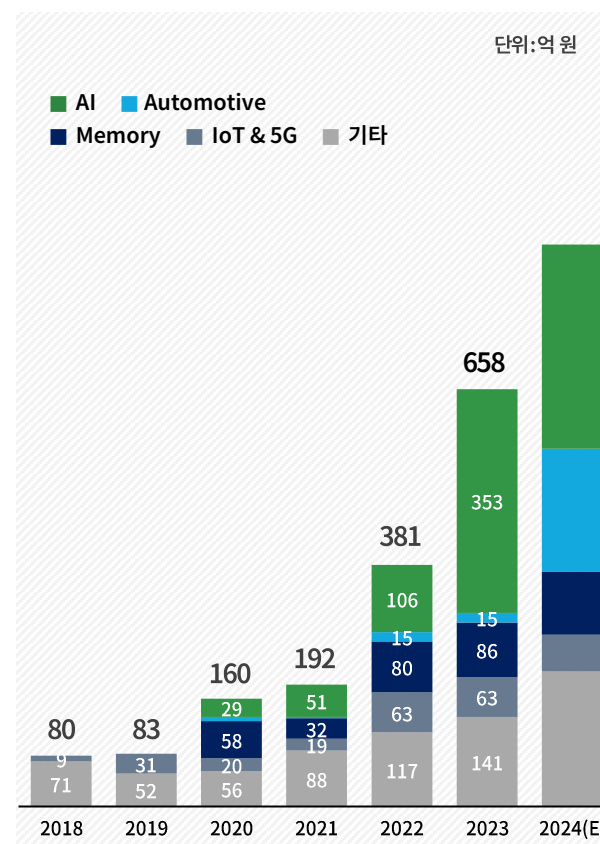
매출유형별 매출액



Application별 매출액(양산)



Application별 매출액(개발)



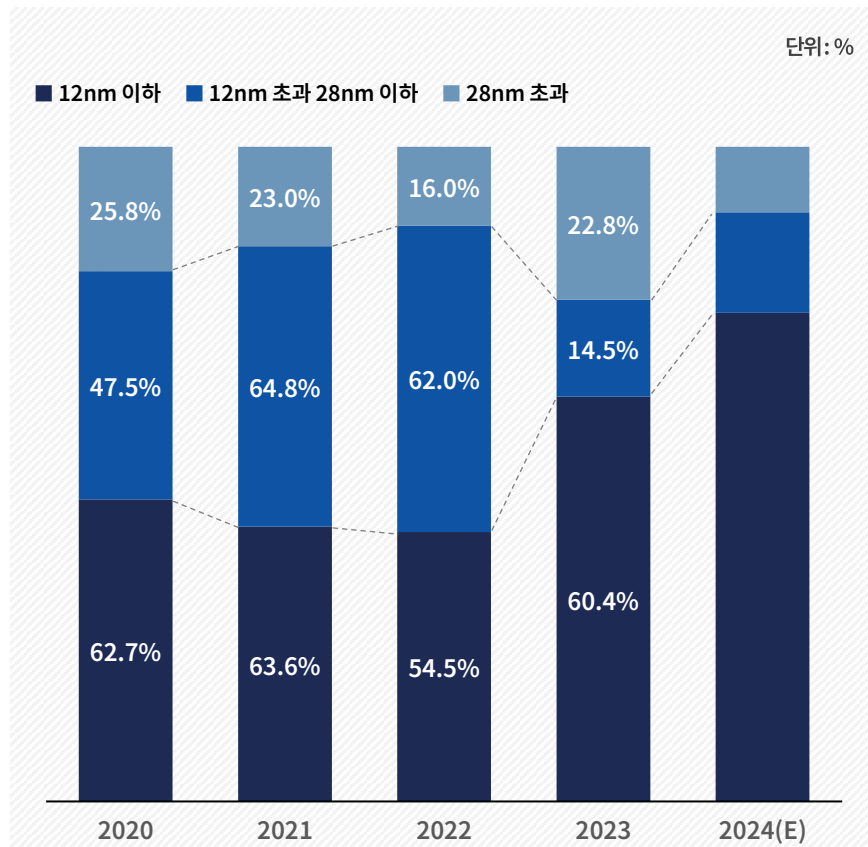
자료 : 연결 기준, 당사 내부자료

03. 서비스별 매출 비중



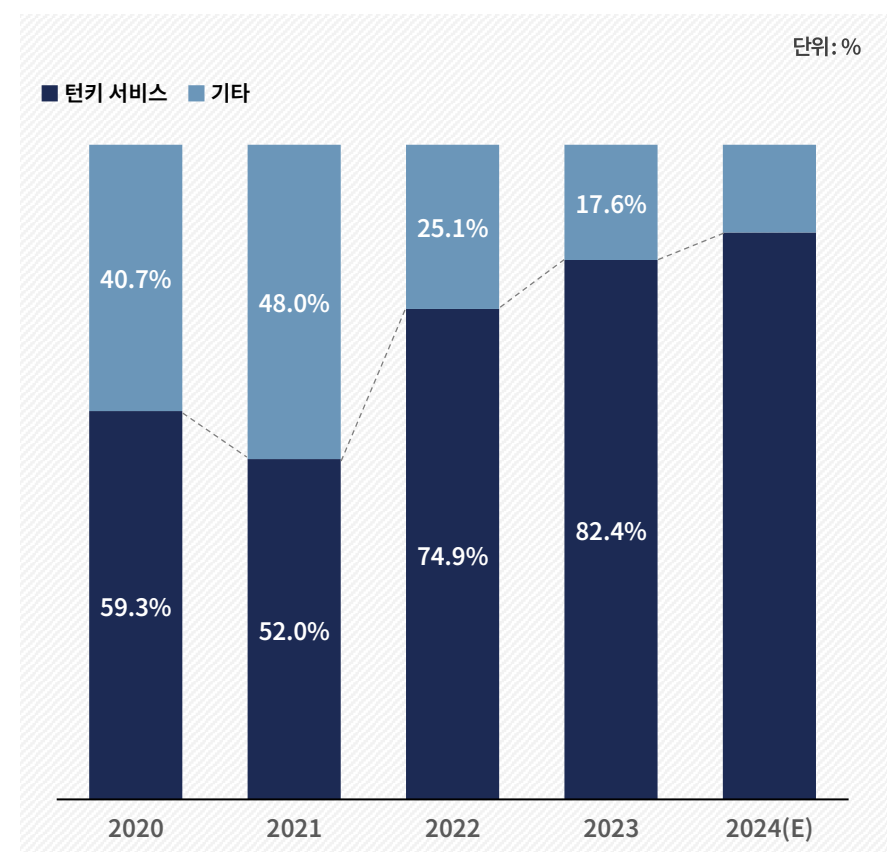
미세공정 및 턴키 프로젝트의 매출 비중이 증가하며 전사 수익성 지속 개선 중

공정별 매출 비중



자료: 연결 기준

턴키 프로젝트 매출 비중



03

Growth Strategy

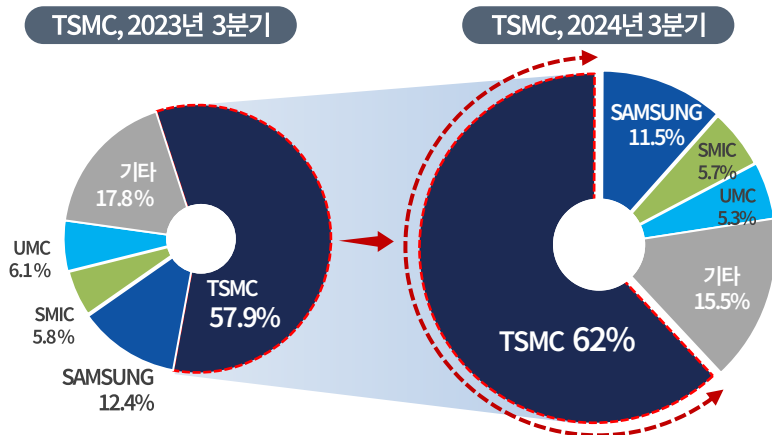
- 01. 글로벌 메이저 파트너와 동반 성장
- 02. 글로벌 성장 전략



01. 글로벌 메이저 파트너와 동반 성장

TSMC, AI생태계 구축을 위해 국내 메모리 기업들과 협업 확대로 에이직랜드 수혜 기대

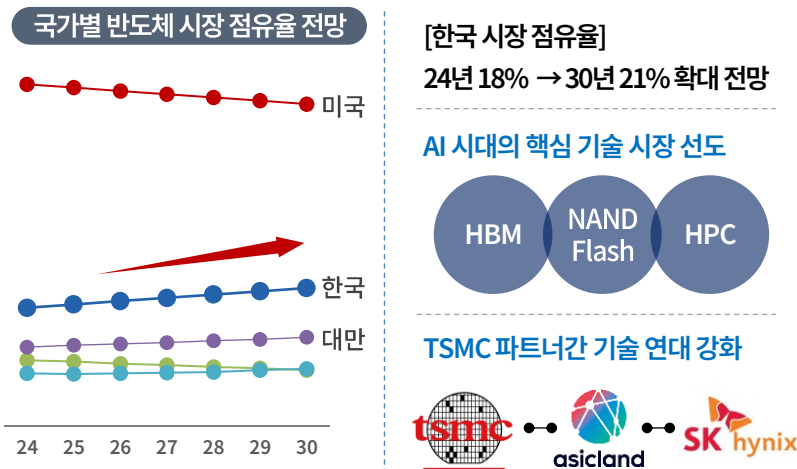
글로벌 시장내 TSMC의 위상 확대



TSMC, 파운드리 시장내 독보적 1위로 격차 확대

- 24년 3분기 매출액 236억 2,200만 달러, 총 이익 57.8%, 순이익 42.8%
- 23년 3분기보다 매출 36.5%, 영업이익 58%, 순이익 54.2% 증가
- 10% 초반대의 삼성전자 순 이익률보다 4배 이상 높은 수치
- 매출 급등의 원인은 선단공정 중심의 AI 관련 수요 증가가 그 원인

글로벌 반도체 시장의 국내 점유율 확대 전망



국내 반도체 시장 확대에 따라 에이직랜드의 역할 확대 기대

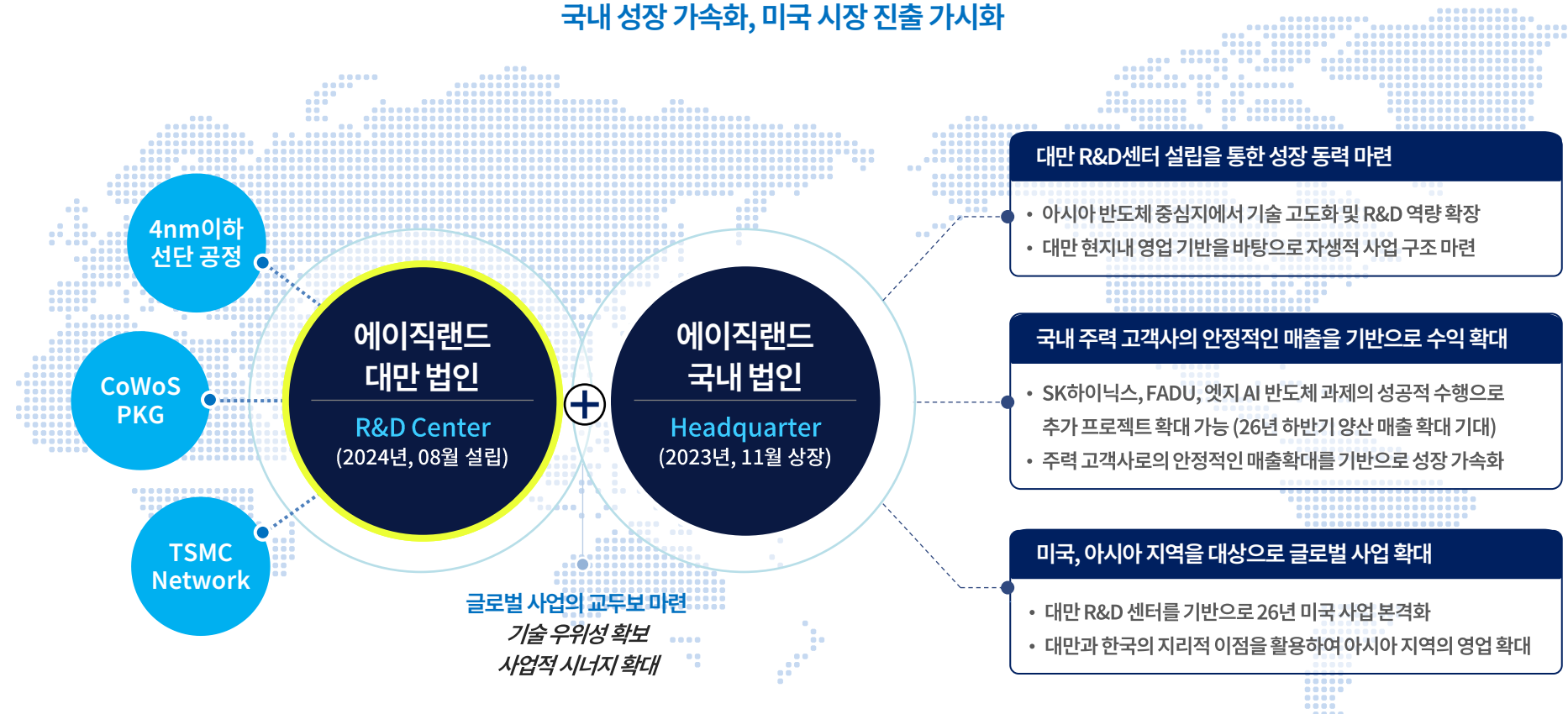
- AI확산에 따른 AI반도체 수요 증가 및 메모리 컨트롤러 시장 확대 (특히 한국 시장은 메모리 반도체 (HBM, NAND Flash) 분야에서 세계 시장을 선도)
- 메모리 반도체를 생산하는 SK하이닉스와 TSMC의 협력이 더욱 확대되는 추세
- TSMC의 국내 유일의 VCA이며, 하이닉스의 개발 파트너사인 당사의 매출 성장 기대 됨

자료 : 연결 기준

자료 : WSTS(World Semiconductor Trade Statistics), Gartner, IDC, TrendForce 등

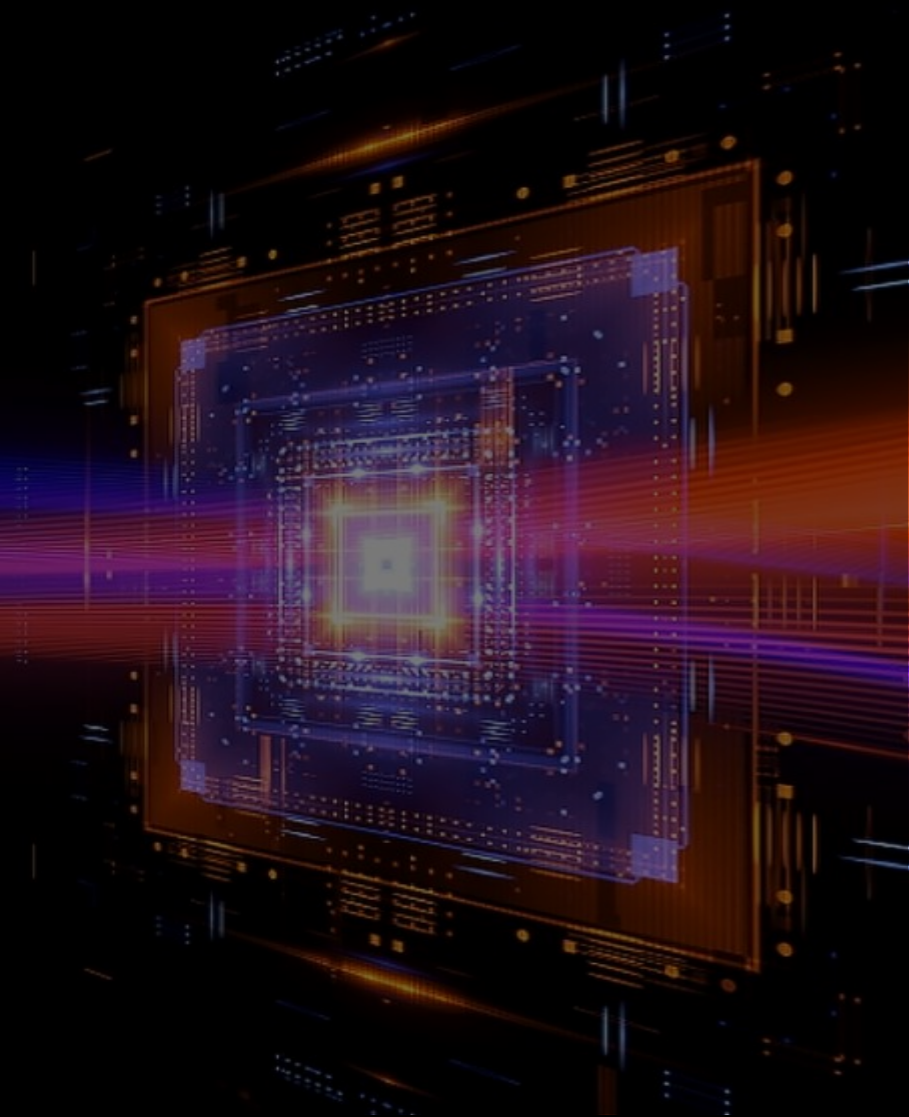
02. 글로벌 성장 전략

대만 R&D센터의 선단 기술력을 바탕으로 글로벌 시장 공략 국내 성장 가속화, 미국 시장 진출 가시화



기존 사업 고도화 및 글로벌 진출로 성장 가속화

Thankyou



Appendix

- 01. 성장 히스토리
- 02. TSMC VCA
- 03. 비즈니스 영역

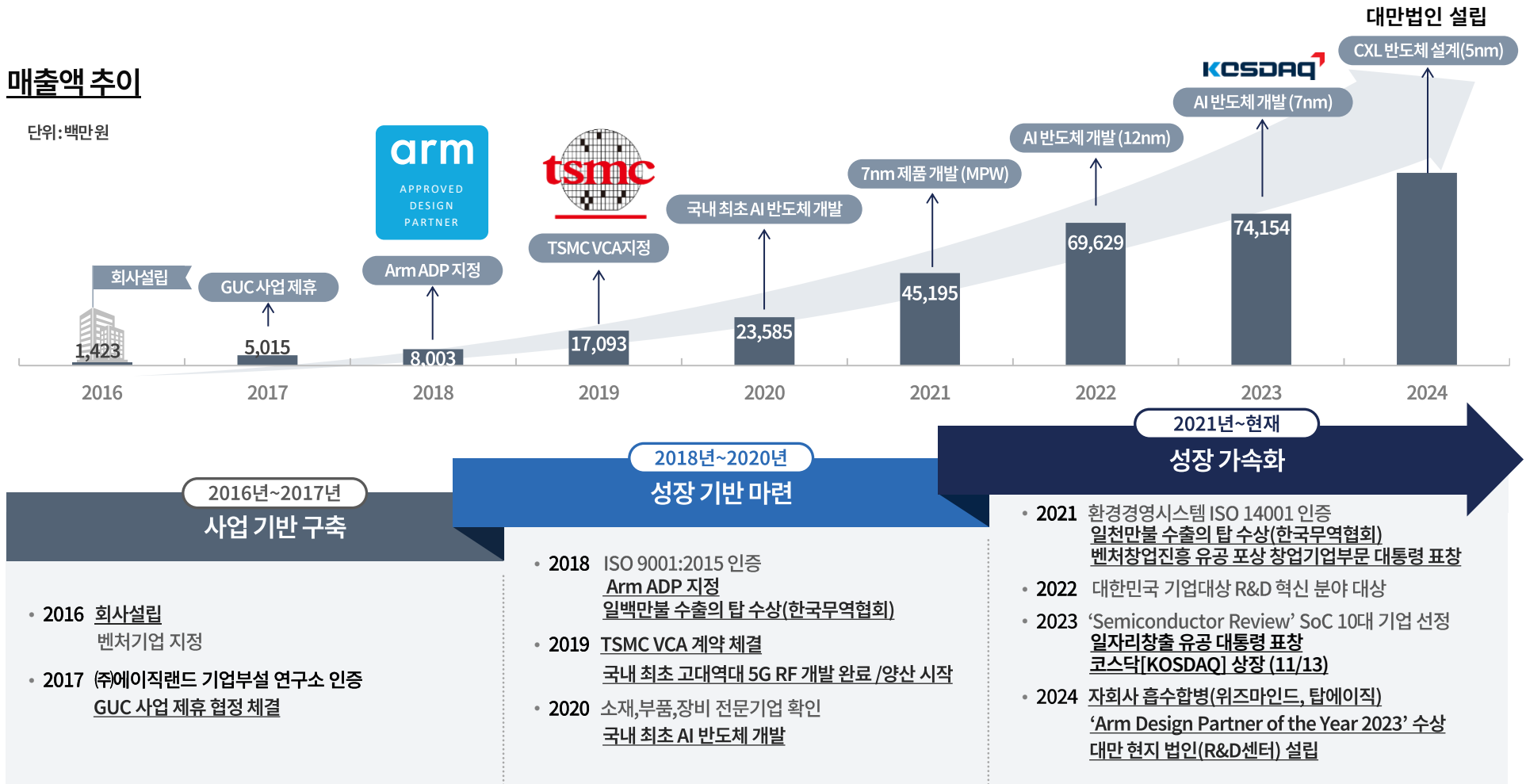


01. 성장 히스토리

10년 이상의 베테랑 설계 엔지니어 기반 글로벌 ASIC 디자인 솔루션 기업으로 성장

매출액 추이

단위: 백만원

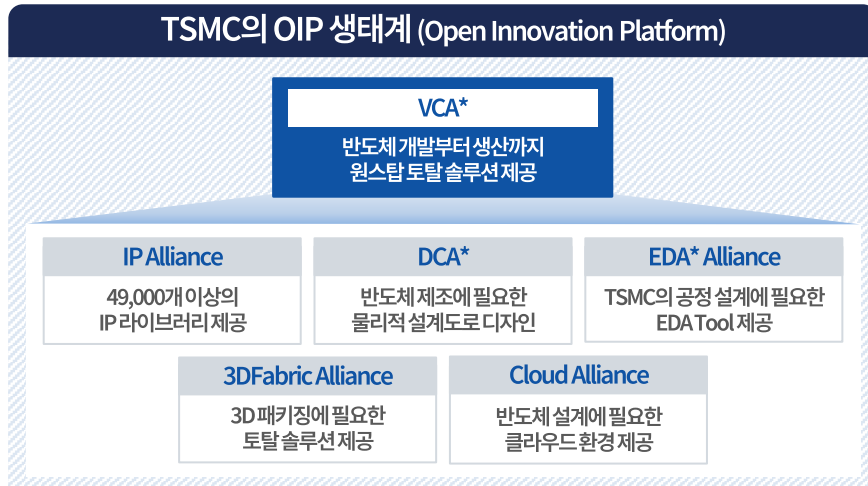
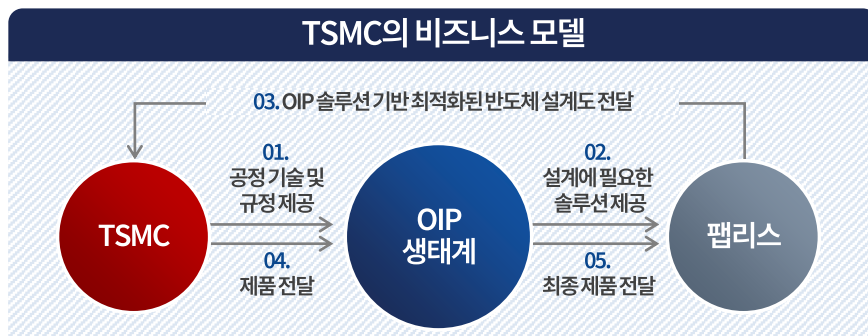


자료: 전자공시 시스템 감사보고서, 당사 내부자료

02. TSMC VCA

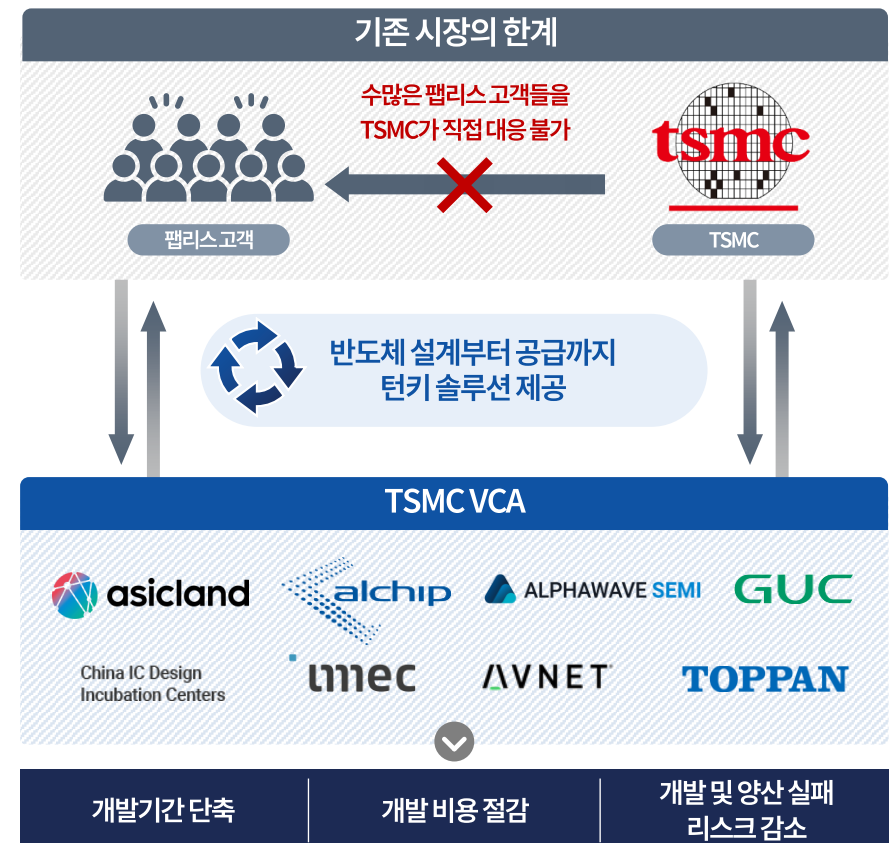
“TSMC VCA”로서 TSMC의 OIP 생태계 내에서 팹리스 고객의 최일선 영업 담당 및 핵심 역할 수행

TSMC의 OIP 생태계 (Open Innovation Platform)



* EDA: Electronic Design Automation
* DCA: Design Center Alliance
* VCA: Value Chain Alliance

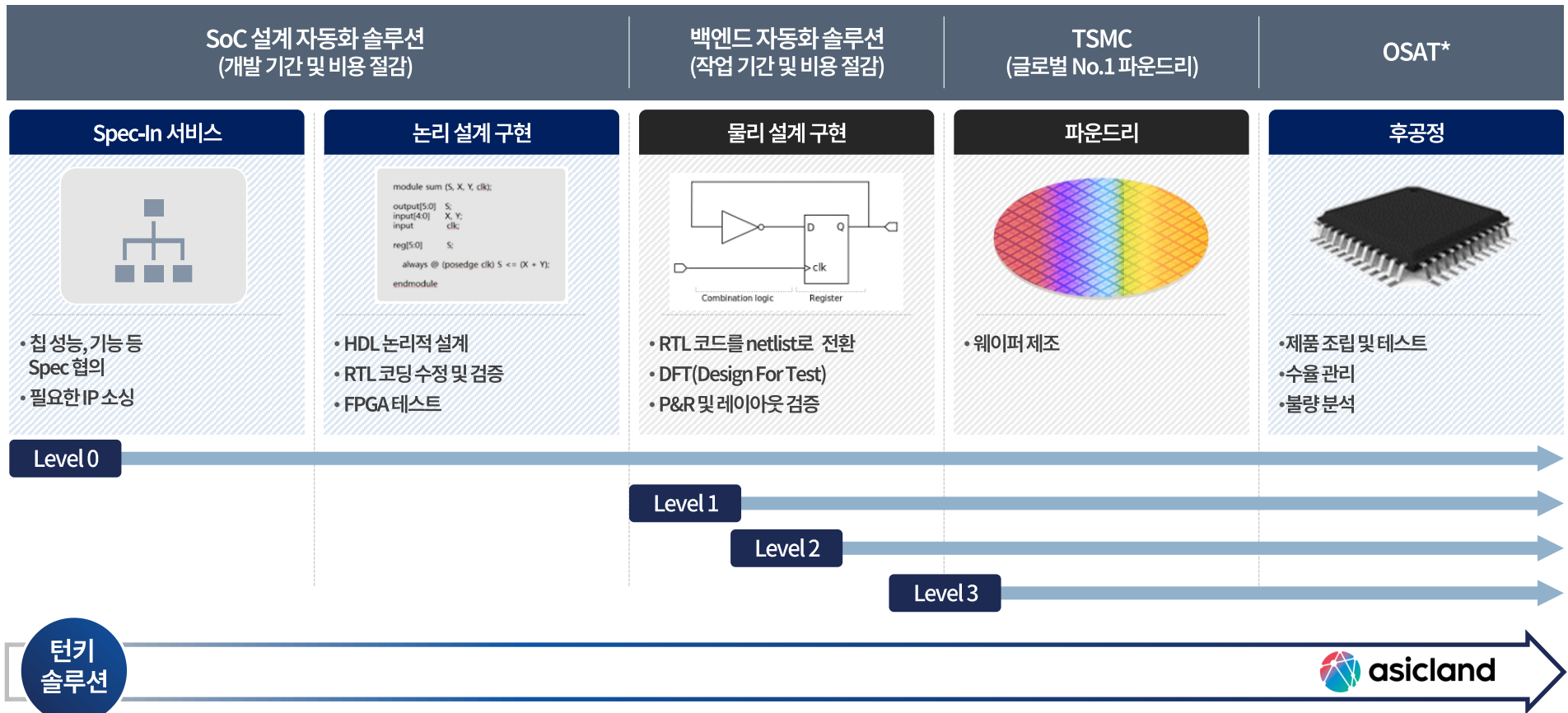
TSMC VCA의 역할 (Value Chain Alliance)



03. 비즈니스 영역

통상적인 디자인솔루션과 차별화된 턴키 서비스(설계~공급) 제공

통상적인 디자인솔루션 영역



* OSAT: Outsourced Semiconductor Assembly and Test